



#### RE470

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados de Ø 1,00 mm (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Distancia entre zonas terminales 0,40 mm y 0,50 mm
- Placa de circuito impreso de adaptación para 23 SMD-QFP diferentes
- Diámetro de agujero 1,00 mm
- Puntos de ruptura controlada prearrayados para separar módulos individuales de la placa de circuito impreso
- Bajo demanda se ponen a disposición gratuitamente los datos Gerber para la fabricación de la máscara inhibidora de la soldadura y impresión de pasta de soldar
- Tamaño 132 x 203 mm

Módulo-No.	Pitch	Pin	mil	Tamaño (mm)
RE470-01	S 0,500 mm	QFP 40, 48	19,7	7,00 x 7,00
	S 0,400 mm	QFP 80	15,7	10,00 x 10,00
RE470-02	S 0,500 mm	QFP 80	19,7	12,00 x 12,00
	S 0,400 mm	QFP 100, 108	15,7	12,00 x 12,00
RE470-03	R 0,500 mm	QFP 120, 128	19,7	14,00 x 20,00
	R 0,400 mm	QFP 100, 108	15,7	10,00 x 14,00
RE470-04	S 0,500 mm	QFP 72, 100	19,7	10,00 x 10,00
	S 0,400 mm	QFP 12	15,7	14,00 x 14,00
RE470-05	S 0,500 mm	QFP 144, 176	19,7	20,00 x 20,00, 24,00 x 24,00
	S 0,400 mm	QFP 184	15,7	20,00 x 20,00
RE470-06	R 0,500 mm	QFP 256, 264	19,7	28,00 x 40,00
	R 0,400 mm	QFP 224, 232	15,7	20,00 x 28,00
RE470-07	S 0,500 mm	QFP 208, 240	19,7	28,00 x 28,00, 32,00 x 32,00
	S 0,400 mm	QFP 264	15,7	28,00 x 28,00